

ボイドを抑え、信頼を上げる。

FLF01-MVF(V)

竹の力で、はんだが変わります!!



※イメージ写真

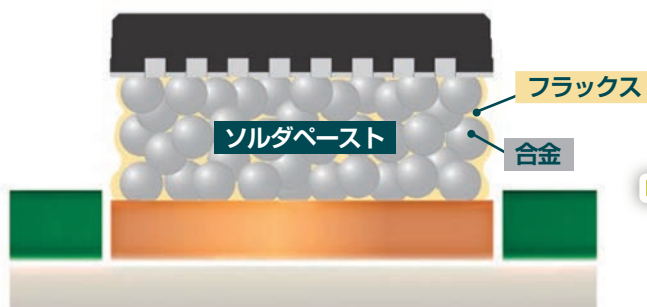
セルロースナノファイバーで実現する、新しいはんだ接合品質

弊社の CNF 含有溶ダペーストは、業界内で初めて採用されてからお客様に愛され続けている**量産実績の高い**溶ダペーストです。

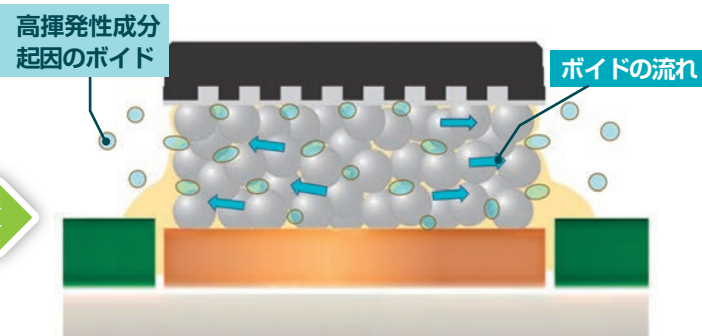
MVF(V) は、その特性と蓄積した技術を元に、改良を重ねた**汎用性の高いボイド低減溶ダペースト**です。

■ボイド発生メカニズム

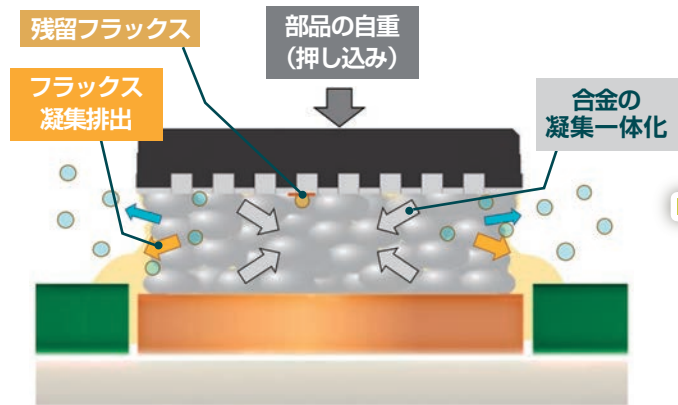
① 印刷 ～ 部品マウント ～ 加熱初期



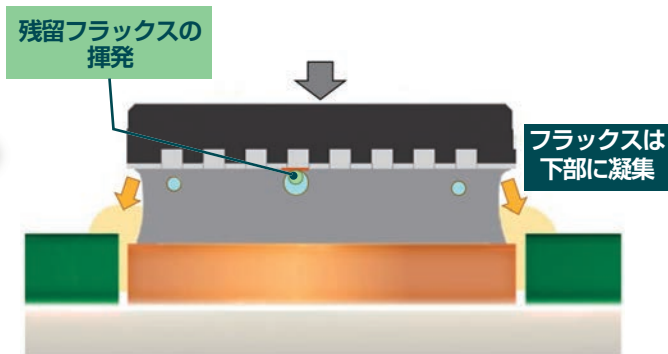
② プリヒート時（はんだ溶融前）



③ 本加熱（はんだ溶融時）



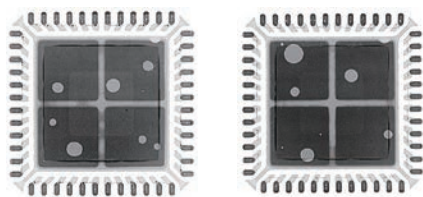
④ ピーク ～ 冷却



■ボイド低減性能

▼0.12mm 厚メタルマスク使用

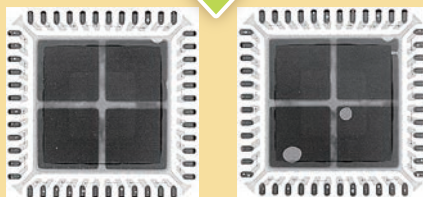
従来品



4.9%

5.2%

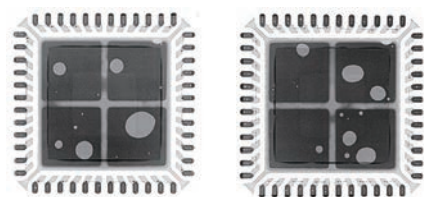
FLF01-MVF(V)



0%

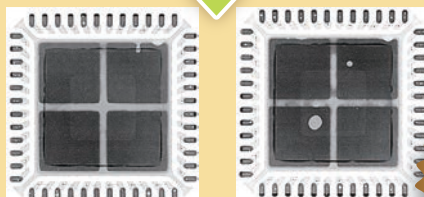
2.6%

▼0.1mm 厚メタルマスク使用



9.4%

8.2%



0.4%

1.2%

ボイドが
低減！